

## Express5800/R120h-2M(2nd-Gen)スペック詳細

## フレームモデル

2019/09/08版

製品名称 モデル名 製品型名		Express5800/R120h-2M			
		8x 2.5型ドライブモデル	24x 2.5型ドライブモデル	8x3.5型ドライブモデル	12x3.5型ドライブ
製品型名		N8100-2775Y	N8100-2776Y	N8100-2777Y	N8100-2778Y
CPU	Processor	インテル® Xeon® プロセッサー Bronze 3204(6C/6T, 1.9 GHz, 8.25MB, TDP 85W), Silver 4208(8C/16T, 2.10 GHz, 11MB, TDP 85W), Silver 4218(10C/20T, 2.20 GHz, 13.75MB, TDP 85W), Silver 4214(12C/24T, 2.20 GHz, 16.5MB, TDP 85W), Silver 4215(8C/16T, 2.50 GHz, 11MB, TDP 85W), Silver 4216(16C/32T, 2.10 GHz, 22MB, TDP 100W), Gold 5215(10C/20T, 2.50 GHz, 13.75MB, TDP 85W), Gold 5217(8C/16T, 3 GHz, 11MB, TDP 115W), Gold 5218(16C/32T, 2.30 GHz, 22MB, TDP 125W), Gold 5220(18C/36T, 2.20 GHz, 24.75MB, TDP 125W), Gold 5222(4C/8T, 3.80 GHz, 16.50MB, TDP 105W), Gold 6226(12C/24T, 2.70 GHz, 19.25MB, TDP 125W), Gold 6230(20C/40T, 2.10 GHz, 27.50MB, TDP 125W), Gold 6234(8C/16T, 3.30 GHz, 24.75MB, TDP 130W), Gold 6238(22C/44T, 2.10 GHz, 30.25MB, TDP 140W), Gold 6240(18C/36T, 2.60 GHz, 24.75MB, TDP 150W), Gold 6242(16C/32T, 2.80 GHz, 22MB, TDP 150W), Gold 6244(8C/16T, 3.60GHz, 24.75MB, TDP 150W), Gold 6248(20C/40T, 2.50 GHz, 27.50MB, TDP 150W), Gold 6252(24C/48T, 2.10 GHz, 35.75MB, TDP 150W), Gold 6254(18C/36T, 3.10 GHz, 24.75MB, TDP 200W), Platinum 8260(24C/48T, 2.40 GHz, 35.75MB, TDP 165W), Platinum 8268(24C/48T, 2.90 GHz, 35.75MB, TDP 205W), Platinum 8280(28C/56T, 2.70 GHz, 38.50MB, TDP 205W), Gold 5215M(10C/20T, 2.50GHz, 13.75MB, TDP 85W), Gold 6238M(22C/44T, 2.10GHz, 30.25MB, TDP 140W), Gold 6240M(18C/36T, 2.60GHz, 24.75MB, TDP 150W), Platinum 8260M(24C/48T, 2.40 GHz, 35.75MB, TDP 165W), Platinum 8268M(24C/48T, 2.90 GHz, 38.50MB, TDP 205W), Gold 5215L(10C/20T, 2.50GHz, 13.75MB, TDP 85W), Gold 6238L(22C/44T, 2.10GHz, 30.25MB, TDP 140W), Gold 6240L(18C/36T, 2.60GHz, 24.75MB, TDP 150W), Platinum 8280L(28C/56T, 2.70 GHz, 38.50MB, TDP 205W)			
	標準搭載数 / 最大搭載数	0/2			
	コントローラ・バスとの接続	DMI3 (8GB/s)			
	インテル® 64	対応			
	インテル® バイチャライゼーション・テクノロジ	対応			
	インテル® ハイバースレッディング・テクノロジ	対応 (Xeon Bronze 3204は除く)			
	インテル® ターボ・ブースト・テクノロジ	対応 (Xeon Bronze 3204は除く)			
	CPUソケット形状	LGA3647			
	ホットプラグ	-			
	冷却方式	ファンなし・ヒートシンク			
チップセット	搭載容量・標準 / 最大	インテル® C621 チップセット 標準搭載なし(レクタプルオプション) / Registered DIMM : 1.5TB (24x 64GB), Load Reduced DIMM : 3TB (24x 128GB)			
	メモリソケット数	24			
メモリ	増設単位	1			
	搭載メモリ	DDR4-2933 Registered DIMM (8/16/32/64GB), DDR4-2933 Load Reduced DIMM (64/128GB)			
	最大動作周波数	2933MHz (CPU毎の最大動作周波数はシステム構成ガイドを参照願います)			
	メモリアクセス方式	23.4GB/s			
	メモリバス構成(チャネルあたり)	インディペンデントチャネルアクセス方式 (メモリ実装方法BIOS設定に応じて12wayインターリーブをサポート)			
	メモリアクセス方式	ECC, x4 SDDC			
	メモリスペーシング	対応			
	メモリミラーリング	対応			
	ホットプラグ	対応			
	モジュールピン数	288ピン			
動作電圧	1.2V				
バックアップ機能	対応				
補助記憶装置	内蔵スロット	フロント	8x2.5型ドライブ	24x2.5型ドライブ	8x3.5型ドライブ
	リア	8x2.5型増設ドライブ(オプション 最大1個)	2x 2.5型ドライブ(オプション 最大3個), 3x 3.5型ドライブ(オプション 最大1個)		
	内部	2x M.2 SATAスロット			
	ドライブベイ				
	内蔵最大	2.5型HDD: SATA 48TB (24x 2TB), SAS 57.6TB (24x 2.4TB) 2.5型SSD: SATA 92.16TB (24x 3.84TB), SAS SSD: 46.08TB (24x1.92TB) (オプションHDDケーージ追加時)	2.5型HDD: SATA 60TB (30x 2TB), SAS 72TB (30x 2.4TB) 2.5型SSD: SATA 115.2TB (30x 3.84TB), SAS SSD: 57.6TB (30x1.92TB) (オプションHDDケーージ追加時)	3.5型HDD : SATA 180TB(15x 12TB),ニアライン SAS 180TB(15x 12TB) + 2.5型HDD: SATA 8TB (4x 2TB), SAS 9.6TB(4x 2.4TB), 2.5型SSD: SATA 115.36TB(4x 3.84TB), SAS SSD: 7.68TB (4x1.92TB) (オプションHDDケーージ追加時)	3.5型HDD : SATA 228TB(19x 12TB),ニアライン SAS 228TB(19x 12TB) + 2.5型HDD: SATA 4TB (2x 2TB), SAS 4.8TB(2x 2.4TB), 2.5型SSD: SATA 7.68TB(2x 3.84TB), SAS SSD: 3.84TB (2x1.92TB) (オプションHDDケーージ追加時)
	ホットスワップ	対応			
	インタフェース規格とRAID構成	SATA 6Gb/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60 (オプション), SAS 12Gb/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60 (オプション)			
	光ディスクドライブ	内蔵/外付ドライブ接続 (オプション)*1			
	FDD	オプション: Flash FDD (1.44MB) *2			
	拡張ベイ				
拡張スロット	対応スロット	標準構成 1x PCI Express 3.0 (x8レーン, x8ソケット) (フルハイト, フルレンジ) 1x PCI Express 3.0 (x16レーン, x16ソケット) (フルハイト, フルレンジ) 1x PCI Express 3.0 (x8レーン, x8ソケット) (フルハイト, ハーフレンジ) 1x PCI Express 3.0 (x8レーン, x8ソケット) (RAIDコントローラ専用) 1x PCI Express 3.0 (x8レーン, x8ソケット) (I/Oカード専用) (オプションのライザカードを手配することでPCI構成を変更可能です。詳細はシステム構成ガイドを参照ください。)			
	規格	PCI Express 1.1, 2.0, 3.0			
グラフィックス	搭載チップ / ビデオRAM	マネージメントコントローラチップ内蔵 / 16MB			
	グラフィックス表示と 解像度	640x480, 800x600, 1,024x768, 1,280x1,024, 1,600x1,200, 1,920x1,200			
標準インタフェース	フロント	1x USB3.0 (Type A) *3, 1x USB2.0 (Type A) (BMC用), 2xUSB2.0 (Type A) (オプション) *12	1x USB3.0 (Type A) *3, 1x USB2.0 (Type A) (BMC用)	1x USB3.0 (Type A) *3, 1x USB2.0 (Type A) (BMC用)	-
	リア	2x USB3.0 (Type A), 1x アナログRGB (i.D-Sub15ピン), 1x マネージメント専用LANコネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応, RJ-45) 4x データLANコネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 (RJ-45)) 1x シリアルポート (オプション) 2x USB3.0 (Type A), 2x SATA 3.0			
ネットワーク	内部	オンボード			
	実装形式	1x Broadcom® BCM5719			
	コントローラ	対応 (オプションボードとの組み合わせはシステム構成ガイドを参照願います)			
	チャミング	対応 (Linuxの対応状況は、NECサポートサイトのLinuxドライバ情報をご参照ください)			
リモート	ジャンボフレーム	対応 (Linuxの対応状況は、NECサポートサイトのLinuxドライバ情報をご参照ください)			
	PXE / iSCSI プート	PXE プート: 対応, iSCSI プート: 非対応			
	コントローラ	BMC			
	マネージメント	Marvell PHY			
WHEA(Windows Hardware Error Architecture)		対応			
キーボード / マウス		オプション			
BIOS Version (出荷当初)		System ROM U30 v2.02 (最新のバージョンはサポート情報のダウンロードサイトでご確認ください)			
BMC Firmware Version (出荷当初)		1.40 (最新のリリースはサポート情報のダウンロードサイトでご確認ください)			
System Sleep State		S0, S5			
冗長電源		対応 (オプション・ホットプラグ可)			
冗長ファン		対応 (標準・ホットプラグ可)			
筐体デザイン		1Uラックマウント			
外形寸法 (幅x奥行x高さ)		445.5mm × 679.4mm × 87.3mm (2.5型ドライブモデル: フロントベゼル/ルーラー突起物含まず) 445.5mm × 730.2mm × 87.3mm (3.5型ドライブモデル: フロントベゼル/ルーラー突起物含まず)		15kg / 45kg	
質量 (最小/最大)		15kg / 38kg		15kg / 46kg	
電源	電源	選択必須オプション AC電源ユニット(N8181-160) 800W 80 PLUS® Platinum取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大: 2) AC100-120V/200-240V±10%, 50/60Hz±3Hz (電源ケーブルは必須選択オプション) AC電源ユニット(N8181-161, 162) 800W 80 PLUS® Titanium/1600W 80 PLUS® Platinum取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大: 2) AC200-240V±10%, 50/60Hz±3Hz (電源ケーブルは必須選択オプション) DC電源ユニット(N8181-163) 800W DC-48V電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大: 2) (電源ケーブルは必須選択オプション) *10 908VA / 899W (800W電源最大値)			
	消費電力(100V最大構成時, 最大電力)	1429VA / 1426W *7			
	消費電力(200V最大構成時, 最大電力)	1504VA / 1501W *7			
	発熱量	5134KJ/h	5404KJ/h	1343VA / 1343W *7	1375VA / 1372W *7
省エネモード(2011年度基準)に基づくエネルギー消費効率		対象外	4835KJ/h	対象外	4940KJ/h
省エネレベル (待機時 / 高負荷時) *4		対象外	対象外	対象外	対象外
省量		34dB / 34dB			
測定方式		ISO7779基準, 待機時垂直測定 (床: 1.5m, サーバへの距離: 1m), サーバ正面 (床: 0.75m, 環境温度23℃ 動作時: 10~35℃(条件付き5~40℃/45℃対応可) *11, 保管時: -30~60℃ 動作時: 8~90℃, 保管時: 5~95℃ (動作時/保管時ともに結露しないこと) VCCIクラス A			
温度条件		Windows Logo 認証, Red Hat Certified Hardware			
湿度条件		スタートアップガイド, 保証書, フロントベゼル			
ハードウェア認証規定		3年オンサイト保守サービス(月~金, 9:00~18:00, 原則営業日対応, 国民の祝日および年末年始等のNEC指定日を除く) 3年パーツ保証			
OS保証		Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2016 Standard, Microsoft® Windows Server® 2016 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2019 Standard, Microsoft® Windows Server® 2019 Datacenter, Red Hat® Enterprise Linux® 7 64bit 5, VMware ESXi™ 6.5 Update2, VMware ESXi™ 6.7 Update2			
主な添付品		最新の動作確認情報は、情報発信サイトLinux on Express5800を参照願います			
無償保証内容					
インストールOS		-			
サポートOS	NECサポート	Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2016 Standard, Microsoft® Windows Server® 2016 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2019 Standard, Microsoft® Windows Server® 2019 Datacenter, Red Hat® Enterprise Linux® 7 64bit 5, VMware ESXi™ 6.5 Update2, VMware ESXi™ 6.7 Update2			
動作確認OS *6					

SelectionPack

製品名称			ExpressSelectionPack			
モデル名			8x 2.5型ドライブモデル			
製品型名			NP8100-2562YP1Y	NP8100-2562YP2Y		
CPU	Processor		Silver 4114(10C/20T, 2.20 GHz, 13.75MB, TDP 85W)			
		標準搭載数 / 最大搭載数	0/2			
		コントローラ・ハブとの接続	DMI3 (8GB/s)			
		インテル® 64	対応			
		インテル® バイチャライゼーション・テクノロジ	対応			
		インテル® ハイバースレッシング・テクノロジ	対応			
		インテル® ターボブースト・テクノロジ	対応			
		CPUソケット形状	LGA3647			
		ホットプラグ	-			
		冷却方式	ファンなしヒートシンク			
チップセット	搭載容量 標準 / 最大		インテル® C621 チップセット			
		メモリソケット数	標準搭載なし(セレクトابلオプション) / Registered DIMM : 1.5TB (24x 64GB), Load Reduced DIMM : 3TB (24x 128GB)			
		増設単位	24			
		搭載メモリ	DDR4-2933 Registered DIMM (8/16/32/64GB), DDR4-2933 Load Reduced DIMM (64/128GB)			
		最大動作周波数	2933MHz (CPU毎の最大動作周波数はシステム構成ガイドを参照願います)			
		メモリバス帯域(チャネルあたり)	19.2GB/s			
		メモリアクセス方式	インディペンデントチャネルアクセス方式 (メモリ変換方法BIOS設定に応じて12wayインターリーブをサポート)			
		誤り検出・訂正	ECC, x4 SDDC			
		メモリスベアリング	対応			
		メモリモデリング	対応			
メモリ	ホットプラグ		-			
		モジュールピン数	288ピン			
		動作電圧	1.2V			
		バッファ機能	対応			
		補助記憶装置	ドライブベイ	内蔵スロット	フロント	8x2.5型ドライブ
					リア	8x2.5型増設ドライブ(オプション 最大1個)
				内蔵標準	内部	2x 2.5型ドライブ(オプション 最大3個), 3x 3.5型ドライブ(オプション 最大1個)
						2x M.2 SATA入 slot
				内蔵最大		2.5型HDD: SATA 48TB (24x 2TB), SAS 57.6TB (24x 2.4TB) 2.5型SSD: SATA 92.16TB (24x 3.84TB), SAS SSD: 46.08TB (24x1.92TB) (オプションHDDケージ追加時)
				ホットスワップ		対応
インターフェース規格とRAID構成				SATA 6Gb/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60 (オプション), SAS 12Gb/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60 (オプション)		
光ディスクドライブ				内蔵/外付ドライブ接続 (オプション)*1		
FDD				オプション: Flash FDD (1.44MB) *2		
拡張ベイ				-		
拡張スロット	対応スロット		標準構成			
			1x PCI Express 3.0 (x8レーン, x8ソケット) (フルハイト、フルレングス)			
			1x PCI Express 3.0 (x16レーン, x16ソケット) (フルハイト、フルレングス)			
			1x PCI Express 3.0 (x8レーン, x8ソケット) (フルハイト、ハーフレングス)			
			1x PCI Express 3.0 (x8レーン, x8ソケット) (RAIDコントローラ専用)			
			1x PCI Express 3.0 (x8レーン, x8ソケット) (LOMカード専用)			
			(オプションのライザカードを手配することでPCI構成を変更可能です。詳細はシステム構成ガイドを参照ください。)			
			PCI Express 1.1, 2.0, 3.0			
			マネージメント専用LANコネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応, RJ-45)			
			4x データLANコネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 (RJ-45))			
グラフィックス	規格		1x USB3.0 (Type A) *3, 1x USB2.0 (Type A) (BMC用), 2xUSB2.0 (Type A)(オプション) *12			
		搭載チップ / ビデオRAM	PCI Express 1.1, 2.0, 3.0			
		グラフィック表示と解像度	マネージメント専用LANコントローラチップ内蔵 / 16MB 640x480, 800x600, 1,024x768, 1,280x1,024, 1,600x1,200, 1,920x1,200			
		フロント	1x USB3.0 (Type A) *3, 1x USB2.0 (Type A) (BMC用), 2xUSB2.0 (Type A)(オプション) *12			
		リア	2x USB3.0 (Type A), 1x アナログRGB (ミニD-Sub15ピン), 1x マネージメント専用LANコネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応, RJ-45) 4x データLANコネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 (RJ-45))			
		内部	1x シリアルポート (オプション)			
		実装形式	2x USB3.0 (Type A), 2x SATA 3.0			
		コントローラ	オンボード			
		チップ	1x Broadcom® BCM5719			
			対応 (オプションボードとの組み合わせはシステム構成ガイドを参照願います)			
ネットワーク	標準インタフェース		対応			
			対応 (Linuxの対応状況は、NECコーポレートサイトのLinuxドライバ情報をご参照ください)			
			PXEブート: 対応, iSCSIブート: 非対応			
			BMC			
			Marvell PHY			
			対応			
			オプション			
			System ROM U30 v2.02 (最新のバージョンはサポート情報のダウンロードサイトでご確認ください)			
			1.40 (最新のリビジョンはサポート情報のダウンロードサイトでご確認ください)			
			S0, S5			
電源	冗長電源		対応 (オプション, ホットプラグ可)			
			対応 (標準, ホットプラグ可)			
			I/Uラックマウント			
			445.5mm x 679.4mm x 87.3mm (2.5型ドライブモデル: フロントベゼル/レール/突起物含まず)			
			445.5mm x 730.2mm x 87.3mm (3.5型ドライブモデル: フロントベゼル/レール/突起物含まず)			
			15kg / 38kg			
			選択必須オプション			
			AC電源ユニット(N8181-160)			
			800W 80 PLUS® Platinum取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大: 2)			
			AC100-120V/200-240V±10%, 50/60Hz±3Hz (電源ケーブルは必須選択オプション)			
消費電力	消費電力(100V最大構成時, 最大電力)		AC電源ユニット(N8181-161, 162)			
			800W 80 PLUS® Titanium/1600W 80 PLUS® Platinum取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大: 2)			
			AC200-240V±10%, 50/60Hz±3Hz (電源ケーブルは必須選択オプション)			
			DC電源ユニット(N8181-163)			
			800W DC-48V電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大: 2) (電源ケーブルは必須選択オプション)			
			別紙参照			
			別紙参照			
			別紙参照			
			対象外			
			34dB(A) / 34dB(A)			
発熱量	省エネ法(2011年度基準)に基づくエネルギー消費効率		ISO7779基準, 傍観者位置測定 (床土: 1.5m, サーバとの距離: 1m), サーバ設置(床土: 0.75m), 環境温度23°C			
			動作時: 10~35°C(条件付きで5~40°C/45°C対応可)*11, 保管時: 30~60°C			
			動作時: 8~90%, 保管時: 5~95% (動作時/保管時ともに結露しないこと)			
			VCCI クラス A			
			Windows Logo Program, Red Hat Certified Hardware			
			スタートアップガイド, 保証書, フロントベゼル			
			3年オンサイト保守サービス(月~金, 9:00~18:00, 前営業日対応, 国民の祝日および年末年始等のNEC指定日を除く)			
			3年パーツ保証			
			Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard *8			
			Microsoft® Windows Server® 2016 Standard			
OS保証	無償保証内容		Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2016 Standard, Microsoft® Windows Server® 2016 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2019 Standard, Microsoft® Windows Server® 2019 Datacenter			
			動作確認OS *6			
			最新の動作確認情報は、情報発信サイト「Linux on Express5800」を参照願います			
サポートOS	NECサポート		Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2016 Standard, Microsoft® Windows Server® 2016 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2019 Standard, Microsoft® Windows Server® 2019 Datacenter			

注意事項

拡張スロット 搭載可能なボードの奥行きはFull Height PCI: ロングサイズ = 312mmまで、ショートサイズ = 173.1mmまで Low Profile PCI: MD1 = 119.9mmまで、MD2 = 167.6mmまでを示します

注釈

- \*1 内蔵DVD-ROMまたは内蔵DVDSuperMULTIを全システムに搭載しない場合、保守時およびOS再インストール時に備えて外付DVD-ROMをシステムで最低1式は必ず手配してください。
- \*2 必要に応じて手配してください。主な用途についてはシステム構成ガイド「Flash FDD製品概要と利用ケース」を参照下さい。
- \*3 VMware ESXi 6.0をインストールした場合、USB2.0で動作します。
- \*4 特定構成(2xCPU(Xeon Silver 4114), 2x16GB DIMM, 1xRAIDコントローラ, 標準ファン, 1x500W電源)での録音値
- \*5 サポートサービスの提供を受けるにはNECよりLinuxサービスの購入が必要です。同一メジャーバージョン内での対応となります。
- \*6 BTOインストール不可、NECは動作確認情報のみ提供いたします。最新の動作確認情報は、情報発信サイト「Linux on Express5800」を参照願います。
- \*7 CPU TDP値は8.12Wをご参照ください。
- \*8 本製品はお客様から提供を要求されている場合に限り、お客様へ販売することが認められています。ご購入の際には、事前にお客様よりWindows Server 2016のライセンス条項に同意していただく必要があります。詳細は<http://jp.nec.com/windowsserver/2016/down.html>をご覧ください。
- \*10 DC-48V電源のほかDC380V電源を本装置で活用されたい方は、弊社営業まで別途お問い合わせください。
- \*11 40°C/45°C環境においてそれぞれ構成制限及び環境制限があります。詳細はシステム構成ガイド「リファレンス」の「40°C/45°C対応」についての注意事項をご参照ください。
- \*12 オプションの「N8154-117 内蔵DVDドライブ増設キット」搭載時